

PROYECTO ALEASOL

TÍTULO DEL PROYECTO: “ALEASOL: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERCONEXIÓN DE CÉLULAS DELGADAS DE GRAN ÁREA MEDIANTE EL USO DE ALEACIONES SIN PLOMO DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN”

CONVOCATORIA DE AYUDAS: Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada. Año 2008

SUBPROGRAMA: Investigación Aplicada - Industrial

FINANCIADO por: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Fondo Europeo de Desarrollo Nacional (FEDER)



Unión Europea

**Fondo Europeo
de Desarrollo Regional**



Una manera de hacer Europa

El proyecto ALEASOL trata sobre el uso nuevas aleaciones y procesos de soldadura para la interconexión de células delgadas y de gran área. Para formar el circuito eléctrico de un módulo fotovoltaico, las células se conectan entre sí mediante la soldadura de cintas de cobre recubiertas de una aleación de soldadura, que unen la cara opuesta de cada célula con la siguiente, correspondiente a los polos positivo y negativo.

En el marco de este proyecto se ha analizado la tecnología de interconexión existente en Isofotón, así como nuevas tecnologías que han surgido recientemente en el mercado, como las aleaciones de bismuto y el proceso de soldadura por inducción y por láser.

El desarrollo del proyecto ALEASOL ha hecho posible la implantación de un proceso de soldadura con aleaciones sin plomo de bajo punto de fusión, con lo que se ha conseguido no sólo disminuir los índices de roturas de células sino también eliminar completamente el plomo en el proceso de interconexión.

En este proyecto han participado los Centros Tecnológicos españoles AIMEN y AIDO, y ha sido financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Fondo Europeo de Desarrollo Nacional (FEDER), mediante la Convocatoria de Investigación Aplicada Industrial según ORDEN PRE/621/2008, de 7 de marzo, (BOE 08-03-2008) por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.